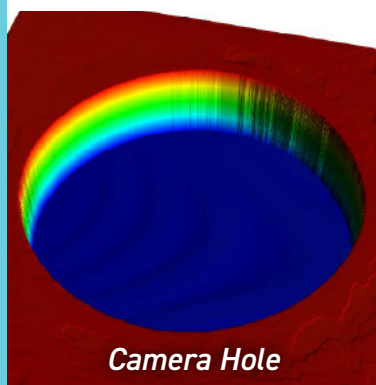
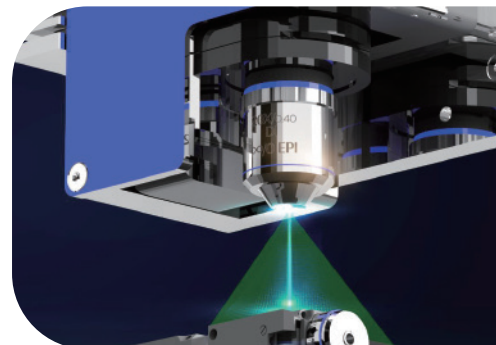
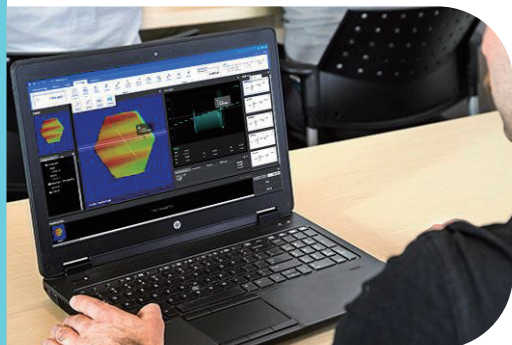


nXI-2

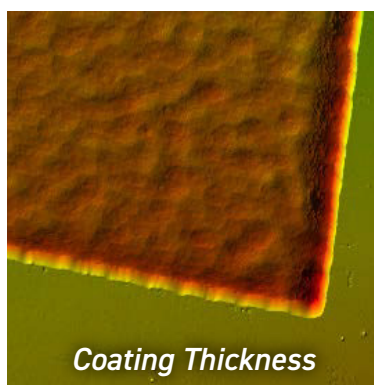
nexensor

大面積 3D 白色干渉変位計

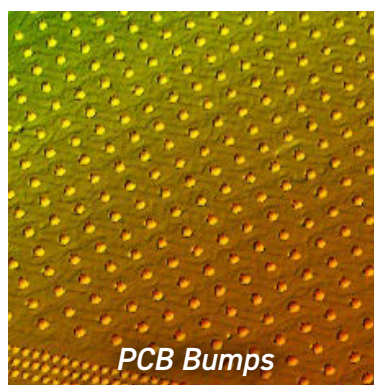
高速に大面積の形状測定



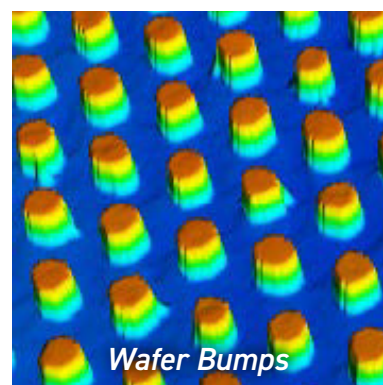
Camera Hole



Coating Thickness



PCB Bumps



Wafer Bumps

- 最大視野 33mm×22mm
- 量産ライン向き的高速測定
- μm スケールの構造の観察が可能
- ソフトウェア付属

Nexensor 社の nXI-2 は最大 33mm×22mm の面積を高速に測定できる 3D 白色干渉変位計です。

測定サンプルにもよりますが 1 秒程度時間で測定し、100nm の繰り返し精度があります。コーティングの厚さ、PCB やウェハの凹凸確認にご利用いただけます。

センサの制御には、組み込みインライン用に対応するインタフェースが提供され、オフラインでの三次元計測・解析用には、付属するアプリケーションソフトウェア NX-SCAN をお使いいただけます。

ARGO corporation

仕様

※お客様サンプルのデモ測定をご希望の場合はお気軽にご相談ください。

システム	測定原理	3D 白色干渉・変位計測技術		
	タイプ	S	M	L
	サイズ	382 × 280 × 104.5mm	429 × 370 × 134.5mm	444 × 465 × 144.5mm
	重量	<7 kg	<10kg	<15kg
	波長	500 ~ 700 (白色光) nm		
	スキャンタイプ	エリアスキャン		
	スキャンレンジ (Z)	300 / 600μm		
	垂直分解能	3 / 6nm		
	HWインターフェース	CXP		
	SWインターフェース	TCPI/IP		
	三次元測定及び解析ソフトウェア	NX-SCANソフトウェア		
光学系	計測エリア	9 × 6 mm	19 × 13mm	33 × 22mm
	WD	27mm	80mm	80mm
	ピクセル分解能	1.95μm	4.29μm	7.09μm
	NA	0.09	0.0583	0.037
	DOF	100μm	350μm	900μm
オプション オートフォーカス	レンジ	±200μm		
	時間	<1 s		

nXScan / nXView

付属ソフトウェア

製品付属の nXScan・nXView はそれぞれ計測用・解析用の専用ソフトウェアです。

計測面のライブビュー表示や計測設定の変更が簡単に行え、特定箇所の段差・幅・角度・体積・粗さ・平坦度などが直感的な操作で確認できます。

